

锦州神工半导体股份有限公司

关于拟投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●**投资标的名称：**（一）硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目；（二）集成电路制造关键材料研发及产业化项目；（三）封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目。

●**拟投资金额：**本项目投资总额约为 112,992.14 万元人民币（以实际投入为准），其中“硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目”拟投资金额为 58,649.80 万元；“集成电路制造关键材料研发及产业化项目”拟投资金额为 32,562.63 万元；“封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目”拟投资金额为 21,779.71 万元。以上项目金额为当前规划下的测算值，公司将根据项目进展、市场环境及资金状况分期按需投入，具体投资规模与实施节奏将根据实际情况动态调整，最终以实际发生金额为准。

●**决策与审议程序：**本次拟投资事项已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。

●**相关风险提示：**公司本次拟投资建设的新项目在技术转化落地、行政审批推进、资金筹措投放及外部市场环境等方面存在多重不确定性。受内外部多重变量影响，项目存在推进不及预期、产能投产滞后、收益目标无法实现的潜在风险，或将对公司产能布局及中长期经营发展产生不利影响。本项目相关规划数据仅为现阶段测算值，不构成公司业绩预测及业绩承诺。请投资者结合公司完整风险披露内容，审慎研判投资风险，理性做出投资决策。公司将依规履行后续信息披露义务。

一、投资建设项目的概述

（一）投资概况

本次开展新项目是基于公司长期发展的战略规划，有助于强化公司核心竞争力并优化公司业务结构，可以满足公司长期发展及生产经营需要，进一步提升公司产业化能力和综合竞争力。本项目拟投资总额约为 112,992.14 万元人民币（以实际投入为准）。

本次项目将与公司现有生产体系、再融资募投项目形成产业协同布局。公司将结合整体发展规划、各项目的建设优先级与资金需求，统筹安排建设时序与资金投放节奏，合理控制年度资本开支规模，保障公司经营稳健与资金使用效率。

（二）投资的决策与审批程序

公司第三届董事会战略委员会第五次会议与第三届董事会审计委员会第十五次会议已审议通过《关于拟投资建设新项目的议案》，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及管理层在符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定、不改变项目核心投资方向的前提下，结合项目实际推进情况、市场环境变化、公司资金储备状况、整体战略布局及再融资募投项目实施节奏，全权办理本次投资项目的全部相关事宜（包括但不限于：调整项目的投资节奏、分期投入计划与具体投资金额等事项）。

（三）不涉及关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资建设项目的的基本情况

（一）项目基本情况

1. 硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目

项目实施主体：锦州神工半导体股份有限公司

项目实施地点：辽宁省锦州市及异地

项目主要内容：硅零部件新品研发及配套硅材料扩产的土地厂房及生产线建设、设备购置安装及其他。

项目投资规模及来源：本项目拟投资金额为 58,649.80 万元（以实际投入为准），资金来源为公司的自有及自筹资金。

项目建设周期：5 年

2. 集成电路制造关键材料研发及产业化项目

项目实施主体：锦州神工半导体股份有限公司

项目实施地点：辽宁省锦州市

项目主要内容：集成电路制造关键材料研发及产业化的土地厂房及生产线建设、设备购置安装及其他。

项目投资规模及来源：本项目拟投资金额为 32,562.63 万元（以实际投入为准），资金来源为公司的自有及自筹资金。

项目建设周期：3 年

3. 封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目

项目实施主体：锦州神工半导体股份有限公司

项目实施地点：辽宁省锦州市

项目主要内容：封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化的土地厂房及生产线建设、设备购置安装及其他。

项目投资规模及来源：本项目拟投资金额为 21,779.71 万元（以实际投入为准），资金来源为公司的自有及自筹资金。

项目建设周期：2 年

（二）项目建设的必要性和可行性分析

当前半导体产业快速迭代，封装、微纳光电领域硅基材料需求持续扩容，高端硅零部件国产替代空间广阔。公司现有产能与产品品类难以充分覆盖下游客户多元化、高端化采购需求，产能供给、新品研发能力存在短板。本次三大项目同步布局，能够补齐和完善公司集成电路材料全品类产品矩阵，抓住国产替代行业机遇，提升高端半导体材料自主供给能力，巩固行业市场份额，支撑企业长期战略发展。

公司深耕硅零部件多年，拥有成熟研发团队、稳定下游客户资源与成熟生产工艺，具备新材料研发、规模化量产的技术积淀。项目选址主要位于锦州，本地半导体产业配套完善，产业政策支持力度充足；资金来源为自有及自筹资金，配套融资渠道通畅。各项目分周期分步建设，长短期产能有序释放，研发、

产线建设方案经过充分论证，技术、场地、资金、市场条件均具备落地实施基础，项目具备较强可实施性。

三、投资建设项目对公司的影响

本次开展新项目是基于公司长期发展的战略规划，有助于强化公司核心竞争力并优化公司业务结构，可以满足公司长期发展及生产经营需要，进一步提升公司产业化能力和综合竞争力。公司对本次投资建设新项目进行了充分的可行性和论证。本项目无其他投资方，公司为唯一实施主体，由公司统筹实施，如后续存在通过子公司实施或其他投资方参与的情形，将根据相关法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。本次投资预计不会对公司正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益情形。

四、投资建设项目的风险分析

1、公司目前核心业务为大直径硅材料、硅零部件业务，产品主要应用于硅零部件设备厂商、下游半导体刻蚀设备等半导体设备厂商、终端存储芯片制造厂商等。本项目系围绕目前产品技术路线，拓展现有业务并开拓新产品，增加新的市场应用。如果该项目因研发进展、技术经验不足而无法实施、延期实施，或产品质量、客户开拓未达预期，则可能影响项目投资进展及预期收益的实现。

2、本项目实施需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次投资所需资金来源于公司自有资金与自筹资金。倘若后续发生宏观经济、行业相关政策、市场行情或自身经营情况出现负面变动，或出现公司其他在建、拟建项目（含再融资募投项目）的资金需求发生变化等情况，进而造成公司自有资金储备不足、自筹融资渠道收紧、融资成本走高，则本次投资项目或将出现建设进度滞后、工期延后、方案变更、暂停乃至完全终止的情形，同时公司整体财务经营状况也可能因此承受负面影响。

4、本次投资建设项目系基于公司战略发展及现阶段市场环境、行业发展趋势等多重考量后确定实施。项目实际落地推进，还将受制于下游客户认证测试进度、行业市场需求波动、行业竞争态势等各类外部与内部条件。

5、本项目投资规模、建设周期等均为预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资

风险。

6、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

7、若前述任一因素发生负面变动，均有可能造成项目投资规划、建设实施进度、产能投放节奏及预期收益难以达成，继而对公司后续经营业绩、产能布局落地及中长期整体发展规划形成不利冲击，提请各位投资者充分留意项目推进及相关市场层面的潜在风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日